

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人 菅原 正倫 様	あて名 〒 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目9番30号 栄山吉ビル 菅原国際特許事務所
----------------------	--

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
〔PCT規則43の2.1〕

出願人又は代理人 の書類記号 PCT0401152S	発送日 (日.月.年) 14.12.2004	
国際出願番号 PCT/JP2004/016346	国際出願日 (日.月.年) 04.11.2004	優先日 (日.月.年) 04.11.2003
国際特許分類 (IPC) Int. C17 H01L33/00		
出願人 (氏名又は名称) 信越半導体株式会社		

1. この見解書は次の内容を含む。

第I欄 見解の基礎
 第II欄 優先権
 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 第IV欄 発明の単一性の欠如
 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第VI欄 ある種の引用文献
 第VII欄 国際出願の不備
 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から2月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 24.11.2004	特許庁審査官（権限のある職員） 道祖士 新吾	2K	3498
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3253		

第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ 配列表

配列表に関連するテーブル

b. フォーマット 書面

コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる

この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

Best Available Copy

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	1-18	有 無
進歩性 (I S)	請求の範囲 請求の範囲	8-10, 14-18 1-7, 11-13	有 無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 請求の範囲	1-18	有 無

2. 文献及び説明

文献1 : J P 7-111343 A (松下電子工業株式会社)
1995. 04. 25, 全文, 全図

文献2 : J P 10-12929 A (日立電線株式会社)
1998. 01. 16, 全文, 全図

文献3 : J P 2000-124475 A (鐘淵化学工業株式会社)
2000. 04. 28, 全文, 全図

文献4 : J P 2002-190619 A (株式会社東芝)
2002. 07. 05, 全文, 全図

請求の範囲 1-7, 11-13

文献1には、発光素子をシリコーン系透明樹脂で覆い、エポキシ系透明樹脂でシリコーン系透明樹脂を覆う構造の光電装置が記載されている。

文献2には、基板側面を傾斜させて断面積を減少させたLEDチップを、システムに銀ペーストで固着させる発光ダイオードの実装構造が記載されている。

文献1に記載されているような、柔らかい樹脂で素子を覆い、堅い樹脂で外側を覆うことで熱応力による信頼性低下を防止する技術は、文献3等にも記載されているように周知技術であり、文献2の断面積を減少させたLEDチップに当該周知技術を用いることは当業者にとって自明である。

請求の範囲 8-10, 14-18

発光素子において、ベース半導体基板に断面増加部を備えることは、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでない。